回路基板加工機講習資料

2010年9月30日(木)

使用前の注意

プリント基板加工システム FP-21A(ミッツ株式会社製)を利用する場合は事前に使用日時の予約をしてください。基板加工機は居室に設置されています。加工中は機械からの騒音によって業務にさしつかえますので、当面の一般の使用日を制限しています。

- 利用日 : 原則的に毎週月曜日と火曜日
- 使用料 : 1,000 円/時間
- 材料費

片面紙フェノール基板=加工範囲 120×100mm 以下無料、120×100mm あたり 100 円程度 片面ガラスエポキシ基板=120×100mm あたり 400 円 両面ガラスコンポジット基板=120×100mm あたり 400 円

CAD 図面:

標準的な配線幅は 0.3mm 以上で設計します。 配線を絶縁する輪郭加工幅の推奨幅は 0.3mm 以上です。 ポリゴンプレーンでベタアースなどの作成時はクリアランスを 0.6mm 幅以上に設定します。

回路基板の作成

回路基板加工機

電子情報技術室で使用している基板加工機の性能(カタログ調べ)

基板加工機 FP-21A



加工範囲	304mm×240mm
加工の目安	ピン間 5 本
最高加工速度	40mm/sec
ドリル下降速度	0.5~5sec
最大加工厚さ	10mm
スピンドル回転	5,000 ~ 30,000rpm

・片面・両面基板の加工で、最小パターン幅 0.1mm・IC ピン間3本以上の 加工が可能。

·Z 軸の最小深さ調節の設定は 3µm 単位。

・パターン幅 0.1mm・IC ピン間5本の加工が可能で高精度・高剛性加工ができる。

1

回路基板加工機用データ作成ソフト

CAD

電子情報技術室では電子回路 CAD に「Protel 99SE」、「EASY CAD」、「PCBE」を使用しています。

Protel 99SE

- ・ 構成部品を選択して回路を作成することで結線情報を取得
- 回路シミュレーション
- ・ 電気的な接続を保ちながら PCB の自動配線

などの統合 CAD ソフトになっています。

商品紹介

URL : <u>http://www.altium.co.jp/protel/migration/mig_99se_prod.htm</u>

EASY CAD

基板加工機に付属する CAD 用ソフト。加工機と同じデータを共有するためデータの変換作業を必要 としません。

手作業で配線

商品紹介

URL : <u>http://www.mits.co.jp/doc/aeasy.htm</u>

PCBE

プリント基板の版下印刷用のガーバデータを作成するパターンエディタ(CAD)で Free wear。この CAD は日本語 Windows 95/98/NT4.0/2000/XP で動作するプリント基板の版下作成用作画ソフト (CAD)で以下のような特徴を持っています。

・ プリンタで印刷し版下を作成できる

・ ガーバファイルや NC データを作成できる

となっています。

ダウンロード先

URL:<u>http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se056371.html</u> などがあります。

\mathbf{CAM}

基板加工機を制御するには専用の統合ソフトウエア FLASH for Windows を使用します。このソフト には CAD データの読込(Converter)、CAD(EASY CAD)、CAM(CAM-21RS)を内蔵しています のでそれぞれに切り替えて使用します。

「EASY CAD」以外で作成されたデータは「Converter」を使用して「CAM-21RS」で利用する PCB データに変換します。変換後には「EASY CAD」を使用して PCB データの修正も可能です。

操作手順は回路図面データの読込、PCBデータの編集、加工機用データ(Gコード)作成後に加工機を 操作します。

簡単な操作手順を列記します。詳細は取扱説明書を参照してください。

スルーホールメッキ処理システム

スルーホールメッキシステムの性能(カタログ調べ)

メッキ層 MPT-DT



メッキ方式	電解型
槽数	5 槽
可能処理範囲	220x230mm
メッキ時間	13µm∕H
最小穴径	0.3mm
基板加振装置	手動

多層基板作成システム

スルーホール多層基板作成システムメッキシステムの性能(カタログ調べ) **基板プレス機**



圧力方式	油圧
圧力	10,000kg
ワークサイズ	300X200mm
層数	6 層まで可能
温度	6 層まで可能

(内層基板の両面に銅箔を貼り合わせる方法:4層の一例)



1) 2・3 層ミリング加工 :内層データを加工します。内層(2・3 層)は両面基板加工です。

:内層基板の両面に銅箔をはり、プレスします

(2・3層のみスルーホールがある場合は、先に処理を済ませます)

- 2)プレス
- 3) 加工機で穴あけ :穴あけ加工を行います
- 4) スルーホールメッキ :スルーホールメッキを行います
- 5) 外層ミリング加工 :1 層と4 層を加工します。

回路基板加工機の使用方法

加工機手順の概略

回路基板の作成手順



操作手順

- Flash for Windows の起動 このアイコンで起動します
- 2. PCB データの読込



3. PCB 図面から加工データへの変換 読み込まれた配線、穴データを元に基板加工機で切削する穴や切削位置のデータを作成します。

Flash for

Windows

- 4. 基板加工機の加工手順
 - 加工準備
 - ・使用する工具、ドリル、基板を準備します。
 - ・基板を加工台に設置しテープで固定します。
 - ・ミリングカッタを取付て刃物の高さを調整します(標準の切削幅は0.3mmです)。
 - ・加工する領域を設定します。
 - 穴あけ加工
 - ・刃物をドリルに付け替え切削範囲の基準となる位置に基準穴を開けます。
 - ・指定されるドリルに付け替え加工するすべての穴位置に穴を開けます。
 - ③ メッキ処理

・スルーホール処理の必要な場合はメッキ処理をします。

- ④ 表面輪郭加工
 - ・必要に応じて基板の位置合わせをします。
 - ・刃物をミリングカッタに付け替え、切削幅を調整して輪郭切削をします。
 - ・切削幅の変更メッセージにしたがって切削幅を調整し輪郭加工を繰り返します。
 - ・最後にランドを仕上げて終了します。
- ⑤ 裏面加工の設定
 - ・回路基板を裏面に置き換え固定します。
 - ・基準穴を元にして基準点を基準穴に合わせて設定します。
- ⑥ 裏面輪郭加工
 - ・表面と同様に裏面を加工します。
- ⑦ 外形加工
 - ・刃物をフォーミングカッタに付け替え、切削深さを調整します。
 - ・外形を切削してから回路基板を取り外します。
 - ・デザインカッタを使用して切残した部分を切断してからヤスリでバリを取り除きます。
 - ・必要に応じて表面に保護膜を塗布します。

刃物の着脱時の注意事項

- 刃物の取り外し時は刃物を下に落とさないよう切り刃の上部を押さえて刃物固定のレバーを静かに 下ろしてください。
- 刃物を取り付ける時は刃物に切り屑やごみのついていないことを確認してコレットチャックの奥まで入っていることを確認して押さえ付けながら刃物固定のレバーを押し上げます。

加工時の注意事項

加工時の設定値表示で刃物の回転速度と加工速度は必ず確認してください。
 回転速度:30(×1000)RPM。
 加工速度:輪郭加工時12 mm/sec以下、外形加工時1~2 mm/sec以内。

この冊子で使用する略語の意味

- Aperture:「アパーチャ」配線基板の線幅やランド形を焼くために光の通過するスリットを使ったこと から、ランドや配線の形状を表す用語として使用。
- CAE :「キャエ」Computer Aided Engineering(コンピュータの援助で技術的な処理)の略称
- CAD :「キャド」Computer Aided Design (コンピュータの援助で設計) あるいは Computer Aided Drafting (コンピュータの援助で図面描き)の略称
- CAM :「キャム」Computer Aided Manufacturing (コンピュータの援助で製造)の略称

DXF :「ディエックスエフ」X/Y座標・線種・属性などを併せ持った図面用データ形式の名称

FLASH for Windows:当室にある基板加工機専用の用統合ソフトウエア

Gerber :「ガーバ」ガーバ社の自社製フォトプロッタ制御用に開発されたプリント基板の配線図形を 記述する作画データの出力形式。でプロッタ制御用コードにも使われる。

- HP-GL :「エイチピィジィエル」Hewlett-Packard Graphics Language ヒューレットパッカード社の プロッタ用に開発されたプロッタ制御用コードの総称
- NC :「エヌシィ」Numeric Control (数値制御)
- PCB :「ピィシィビィ」Printed Circuit Board (プリント回路配線基板)の略称

Rubout :「ラブアウト」

モーダル:「modal」穴あけなどの同じコマンドを繰り返す時に移動する座標だけを入力し繰り返し加 工する方法の名称 [追補]

PCBE 使用時における注意事項

アートワーク条件のDコード0から3までは加工機ソフトのシステム変数として使用しますので使用 しないでください。

単位系はmmを使用します。

PCBE の編集後にガーバファイルを出力します。

- 1. 出力するファイル名、レイヤーの設定は、ダイアログの設定か、メニュー 設定→ガーバ出力設定 で行います
- 2. ガーバファイルは、基板ファイルと同じフォルダに出力されます。
- 3. アパーチャ加工条件は同じフォルダの gout.lst ファイルに出力されます。
- 4. ドリル加工条件は同じフォルダの hout.lst ファイルに出力されます。
- 5. 必要なデータは表面・裏面・外形データ(*.GRB) 穴データ(Hole.hol)、設定データ(gout.lst、 hout.lst) です。

*反転(ミラー)出力する時は、保存されているファイルを読込み、複数選択で必要な要素を選択後に反転して出力し、名前を付け替えて保存します(上書き保存しない限り元ファイルは変更されません)。 *インチ出力は、有効桁数とmmから変換する関係で精度が落ちます。

*基板メーカーのガーバ・コマンドが、モーダルをサポートしていない場合、"同一コマンド1回"のチェックを外して下さい(普通はモーダルをサポートしています)重複(同一)座標の省略

Flash For Windows を起動させて PCBE のデータを使用できるように各種加 工条件の設定をします。

1. コンバータの画面に切り替えます。

鳥 Flash for W 智 ファイル(E) フォトデータ変換

> 73hデータ E¥FLAS -座標でア -ターミネCI -単位の1 - ×反転 -で い - ×反転 -で し - × で い - × で い - × で い - × で い - × で い - × で い

- 2. 加工条件に記載されている内容を元にフォトデータ変換条件を編集、確認 します。
- 3. 同様にドリル変換条件も編集、確認してください。

indows - CONVERTER - [無題]	🚊 Flash for Windows - CONVERTER - [無題]
編集(E) 表示(V) 情報(M) 設定(S) 条件(C) 変換条件(M) ウ.	1 77(N(E) 編集(E) 表示(V) 情報(M) 設定(S) 条件(C) (変換条件(M))
条件設定 X GPR GPR	穴データ変換条件設定 ▲ GPR GPF
変換条件ファイル I / ジリッ HWIN#Qconv#GBCONV.GIF	穴デー物変換条件77ℓル E¥FLASHWIN4Qconv¥GBCONV.GIF
ブンリュート C インクリメンタル OK OK	座信糸 ● アブンリュート ○ インクリメンタル OK OK OK OK OK OK OK O
-9 ++>)th	ターミネーターキャンセル
RILF @ #	© CR·LF O *
	_单位系
000 (mm)	0.001000 (mm)
	×反転
乱) ○する	○しない ○する
and the second	
au Oする	でしない Cする
11/2	
a) C f S	© しない 0 する
1_万条件山中	
ノ本(mu)) 乱) Cする	and the second

